



平成30年2月14日

各位

会社名 セイコーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 吉伸
(コード番号 8050 東証第1部)
問合せ先 経理部長 坂本 和彦
(TEL 03-3563-2111)

特別利益の計上に関するお知らせ (開示事項の経過)

当社は、平成30年3月期第4四半期連結会計期間において、下記のとおり特別利益を計上する見通しとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 特別利益の計上

当社子会社であるセイコーインスツル株式会社（以下、SII）は、株式会社日本政策投資銀行（以下、DBJ）との間で、SIIの半導体事業を両社の共同出資による半導体事業会社のエスアイアイ・セミコンダクタ株式会社（以下、SSJ）へ移管すること、並びに、その後2年経過時点以降にSIIが保有するSSJ株式の一部をさらにDBJに譲渡するオプション等を含む契約（以下、当該契約）を平成27年9月8日付で締結いたしました。

当該契約に基づき上記オプションが行使されたことから、SIIはDBJとの間で株式譲渡契約を平成29年12月1日付で締結し、平成30年1月5日にSSJ株式の一部をDBJに譲渡いたしました。

上記事業移管時に発生した移転利益を共通支配下の取引として連結財務諸表上消去しておりましたが、当該株式譲渡に伴いSSJが当社の連結範囲から除外され、当該移転利益のうち株式譲渡後の所有株式数に対応する部分を除いた金額が実現いたしました。

当該株式譲渡に伴う未実現利益の実現額は95億円（概算）であります。

また、平成30年3月期第4四半期連結会計期間において、当該株式譲渡に伴う特別利益93億円（概算）を計上する見通しであります。内訳は上記の未実現利益の実現額が95億円（概算）、株式譲渡損等が1億円（概算）であります。

なお、エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社は、平成30年1月5日付でエイブリック株式会社へ商号を変更しております。

2. 今後の見通し

当該特別利益につきましては、平成29年11月14日に公表いたしました平成30年3月期の連結業績予想に概算で織り込んでおります。

(参考) 当期連結業績予想 (平成29年11月14日公表分) 及び前期連結実績

(金額単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
当期連結業績予想 (平成30年3月期)	270,000	9,000	10,000	10,000	242.62円
前期連結実績 (平成29年3月期)	257,115	7,487	6,671	5,392	130.71円

※平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算出しております。

以上